

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-079

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于参与共建车规半导体产业技术研究所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为把握汽车产业智能化，电动化和网联化带来的新机遇，通过引入、孵化与培育研发团队，致力于车规半导体新工艺、新材料、新设备的研发与战略布局，充分发挥苏州园区、苏州产研院等共建方的资源与品牌优势，聚焦车电半导体创新需求，逐步构建产业生态链，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市产业技术研究院（以下简称“产研院”）、苏州工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）、“车规半导体产业化技术研究所”团队（以下简称“研究所团队”）共建“苏州市产业技术研究院车规半导体产业技术研究所”（以下简称“研究所”），研究所注册资本 1000 万元人民币，建设周期五年，现将相关情况说明如下。

一、研究所建设方案基本情况

（一）投资方情况

研究所注册资金拟为 1000 万元人民币，由公司、苏州思萃创业投资有限公司（以下简称“思萃创业”，代表产研院）、苏州工业园区领军创业投资有限公司（以下简称“领军创投”，代表园区管委会）、研究所团队共同出资设立，其中公司认缴出资人民币 300 万元，占注册资本比例为 30%，思萃创业认缴出资 150 万元，占注册资本比例为 15%，领军创投认缴出资 150 万元，占注册资本比例为 15%，研究所团队认缴出资 400 万元，占注册资本比例为 40%，研究所团队由公司董事长、总经理王蔚先生牵头组建，并由王蔚先生兼任研究所所长职务。

（二）、建设运营情况

1、建设周期。研究所的建设周期为五年，自 2021 年 12 月 25 日至 2026 年

12月24日。

2、建设定位。研究所以发展和推动苏州车规半导体产业为目标，将在智能传感，高级辅助驾驶，车用动态交互，三代半导体高功率器件等方向展开深入研究并形成相关技术和项目的产业集聚，围绕核心工艺，核心材料，核心设备搭建产业化标准与生态圈。

3、共建方支持。建设周期内，产研院、园区管委会及公司将根据研究所的运营建设及目标考核结果，提供启动资金、科技经费、建设经费、项目经费等相关资源支持。

其中产研院给予研究所的支持包括：（1）经费支持。给予研究所2000万元经费支持，其中建设经费支持1000万元，项目经费支持1000万元。（2）标识使用。将研究所纳入苏州市产业技术研究院专业研究所体系进行管理、考核，给予研究所苏州市产业技术研究院专业研究所的相关政策扶持，授权研究所使用“苏州市产业技术研究院车规半导体产业技术研究所”名称及苏州市产业技术研究院专用标识。（3）科研项目申请。支持、指导研究所申请国家、江苏省、苏州市重点科研项目。协调市产研院体系内相关兄弟院所，在业务、技术、人才等方面与研究所进行合作。

园区管委会给予研究所的支持包括：（1）经费及政策支持。给予研究所2000万元的相关支持，其中启动资金支持1000万元，科技经费支持1000万元。（2）投资支持。在研究所孵化及衍生的项目，优先支持园区国资基金参与投资。

公司向研究所的提供包括运营、项目合作、委托开发、应用场景及示范项目等方面资源支持，支持金额为人民币4000万元，用于研究所建设、运营、研发等使用，其中，在研究所注册成立且各共建方的注册资金到位后提供800万元人民币，剩余部分公司将根据研究所建设目标完成与考核结果分次提供。

二、本次交易构成关联交易

（一）关联关系介绍

公司本次拟参与研究所的共建方案，向研究所进行投资，提供资源支持，同时公司董事长、总经理王蔚先生拟兼任研究所所长职务，牵头组建研究所团队并向研究所进行投资，因此，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次交易履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于参与共建车规半导体产业技术研究所的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。

三、本次投资对上市公司的影响及风险提示

本次参与研究所的共建，充分利用政府、产研院等共建方的资源支持，通过引入、孵化与培育研发团队，对车规半导体新工艺、新材料、新设备展开研发与战略布局，以车电半导体需求为聚焦点构建产业生态链，有利公司更好把握汽车产业智能化，电动化和网联化带来的新发展机遇。

研究所的建设与运营过程可能会受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等外部因素、以及自身技术开发与市场拓展进展不利的影 响，可能会存在投资损失的风险，公司将积极协同各共建方资源，有效推进研究所建设方案的顺利实施，以有效降低投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日